

Fiche d'application n° 50

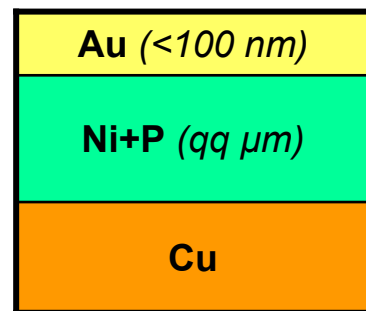
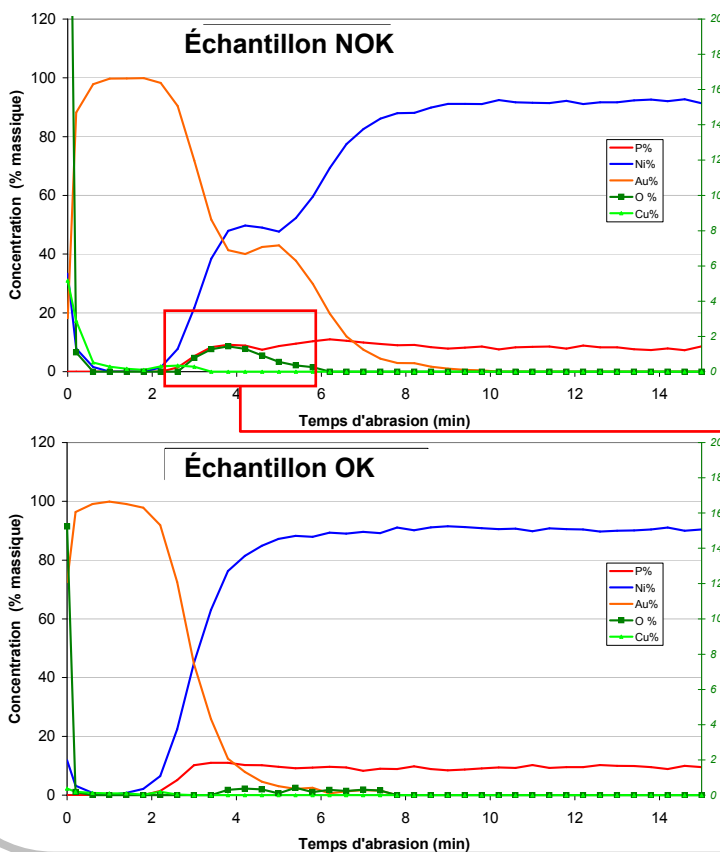
Défauts de type « black pad » sur un PCB

Objet : Recherche de l'origine d'un défaut de soudabilité de composants sur un PCB

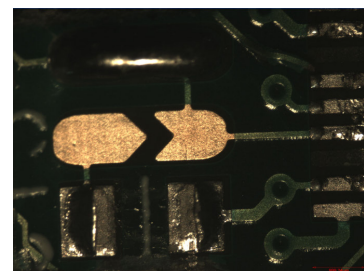
Technique mise en œuvre : XPS

- ✓ Profil quantitatif de répartition en profondeur
- ✓ Epaisseur des couches: de quelques centaines de nm à quelques μm

Résultats :



Oxydation à l'interface entre la
couche d'or et le revêtement NiP



Empilement Cu/NiP/Au

Conclusion :

Le défaut de soudabilité s'explique par un phénomène d'oxydation du matériau localisé à l'interface couche d'or/revêtement NiP.